

2020年3月期

第2四半期 決算説明会

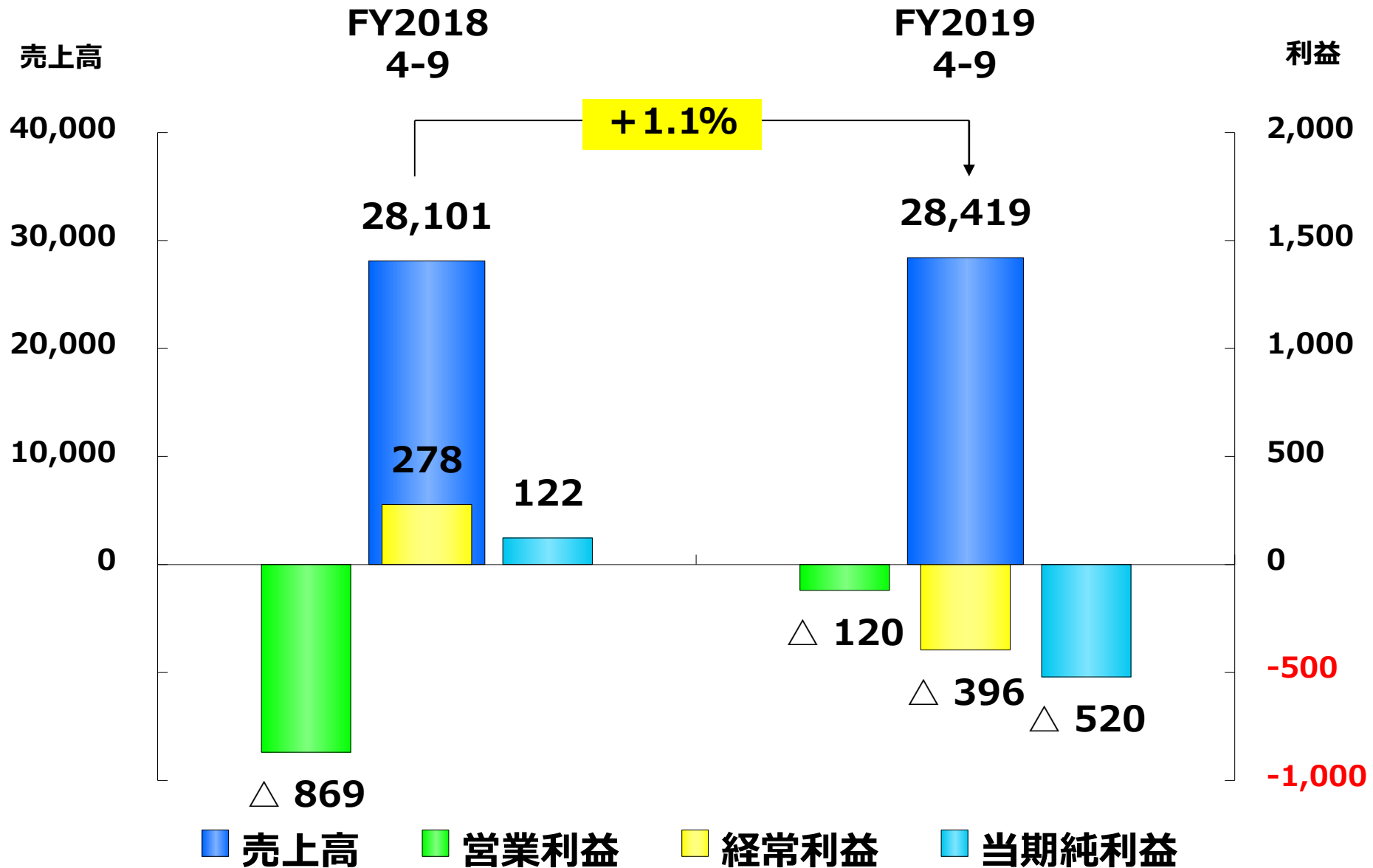


FY2019 2Q決算の概況

常務執行役員 大垣 幸平

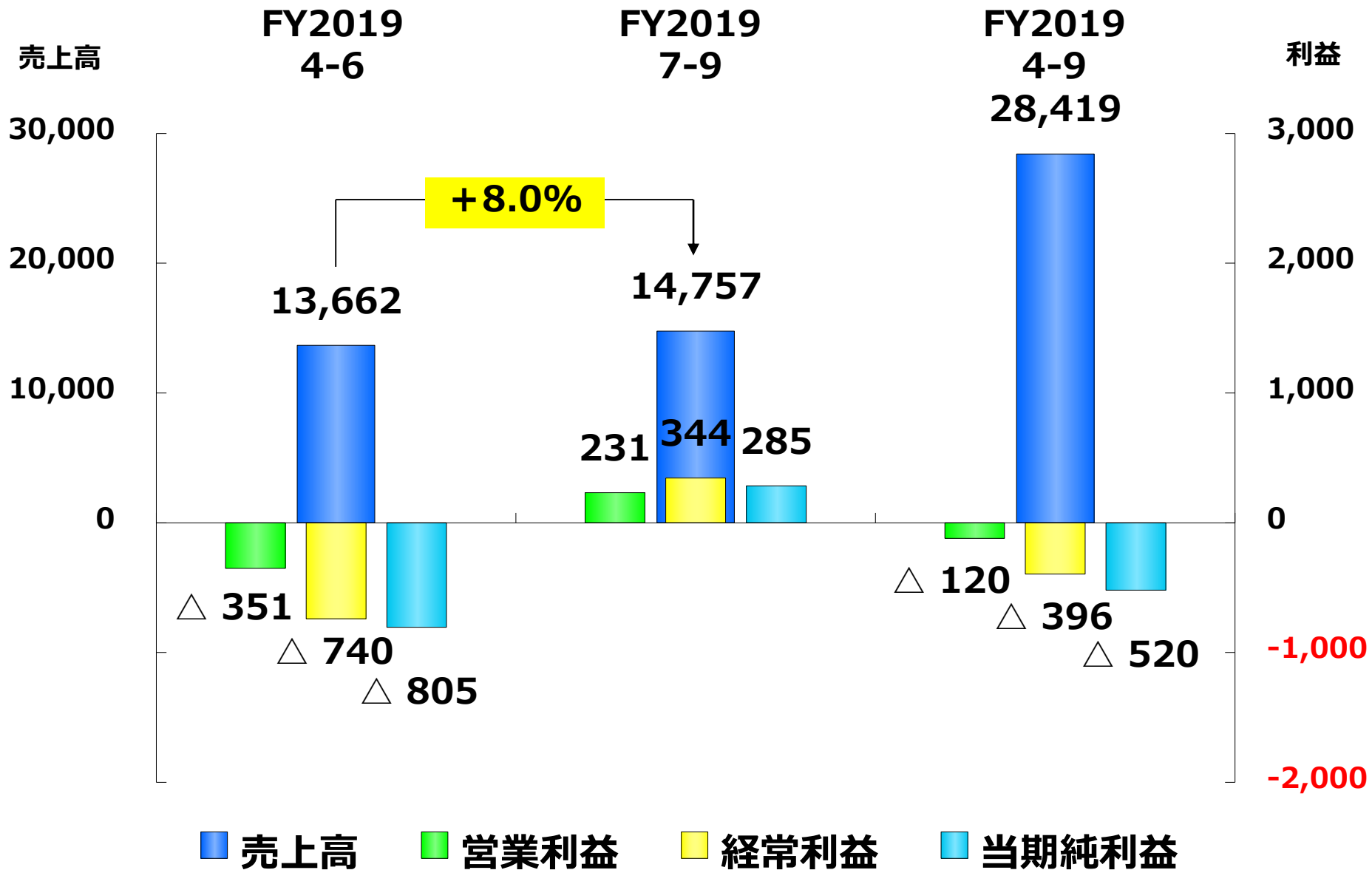
<連結> 第2四半期業績

(単位：百万円)



〈連結〉第2四半期業績(四半期別)

(単位：百万円)



<連結> 営業費用

(単位：百万円)

FY2018
4-9FY2019
4-9

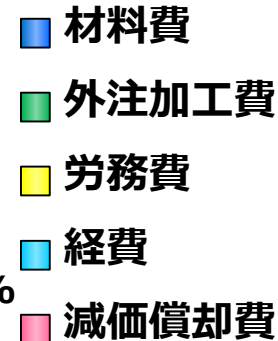
28,970

28,539

():売上比

(103.1%)

(100.4%)



- 材料費・外注加工費率 1.7%増加
51.0% → 52.7%
プロダクトミックスによる材料費率悪化
- 労務費・経費率 3.9%減少
46.1% → 42.2%
固定費削減による労務費・経費率の減少

営業利益

△869

△120

(△3.1%)

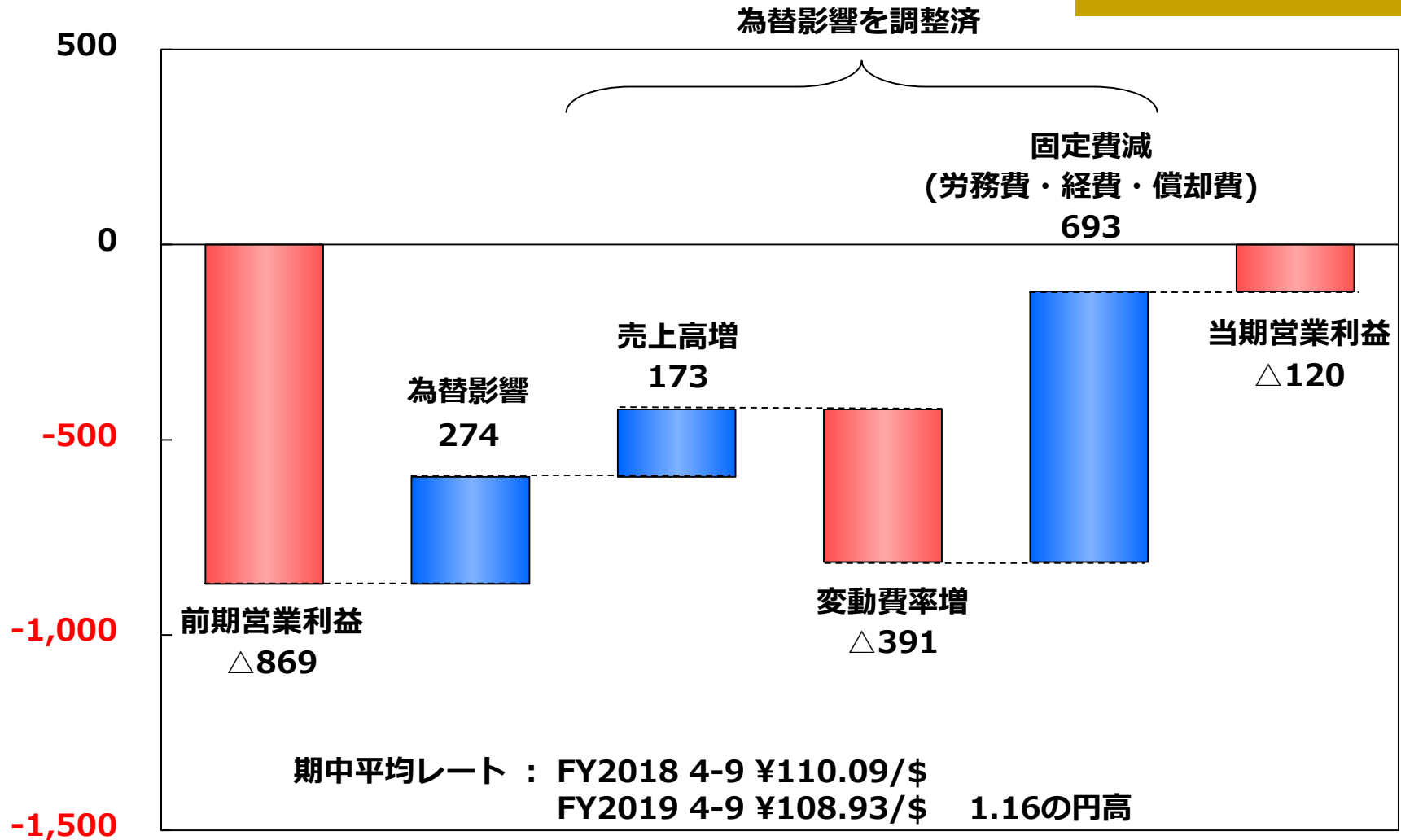
(△0.4%)

＜連結＞ 営業利益分析

(単位：百万円)

連結営業利益増減要因分析
[FY2018 4-9 対 FY2019 4-9]

Total
+749百万円

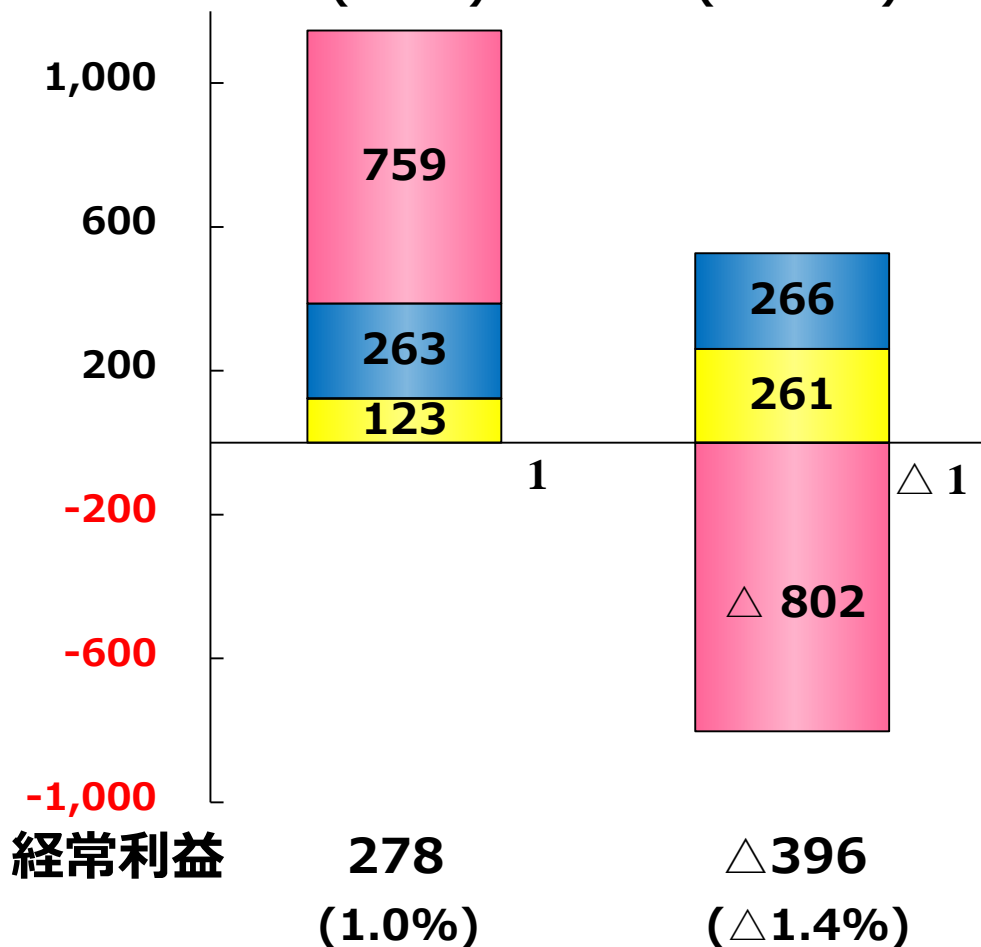


＜連結＞ 営業外損益

(単位：百万円)

FY2018
4-91,147
(4.1%)FY2019
4-9△276
(△1.0%)

():売上比



- 為替差損益
- 不動産収支
- 金融収支
- その他

為替差益 759→為替差損 △802百万円

1. FY2018 4-9

2018/3 ￥106.24/\$

2018/9 ￥113.57/\$ 7.33の円安

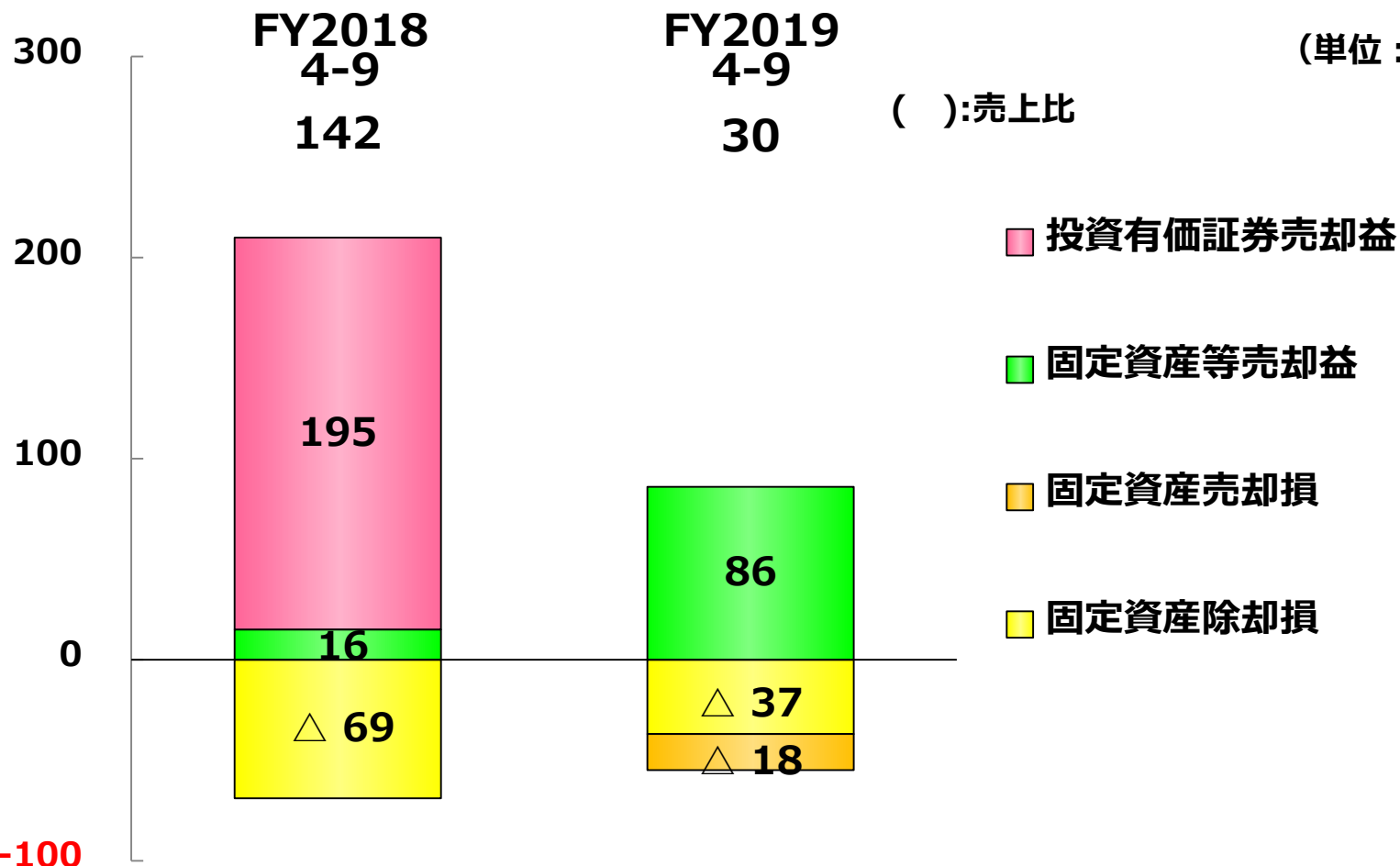
2. FY2019 4-9

2019/3 ￥110.99/\$

2019/9 ￥107.92/\$ 3.07の円高

〈連結〉特別損益

(単位：百万円)



税引前利益

420

△366

税金等 (含税効果処理)

△297

△154

当期純利益

122
(0.4%)△520
(△1.8%)

<連結>セグメント情報

FY2019 4-9

(単位：百万円)

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	CS事業部	SCI事業部	開発センター	計		
売上高	9,629	18,616	139	28,385	34	28,419
セグメント利益 又は損失(△) (営業損失)	△28	80	△154	△101	△19	△120

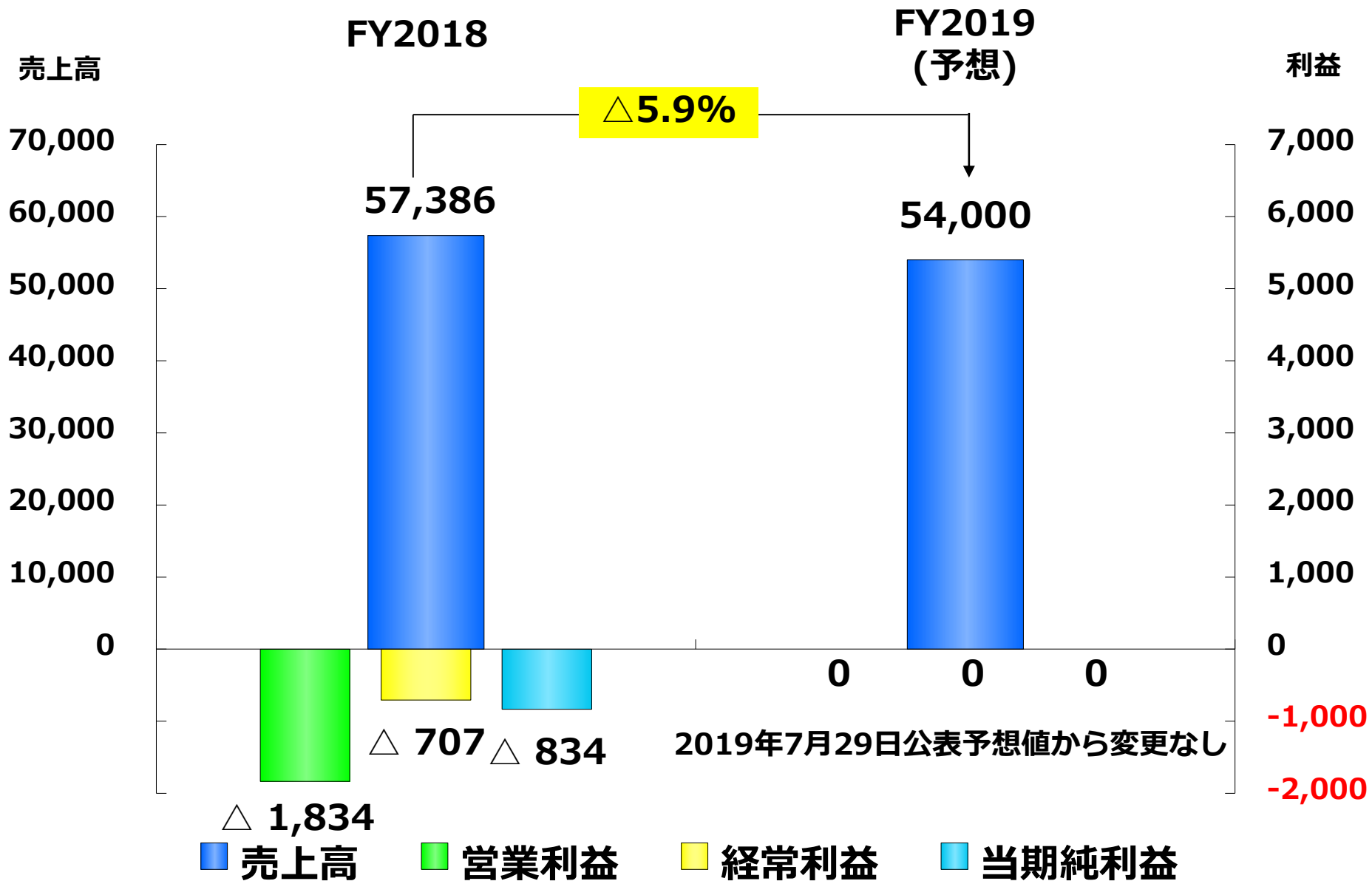
FY2018 4-9

	報告セグメント				その他 (注)	合計
	CS事業部	SCI事業部	開発センター	計		
売上高	11,436	16,468	188	28,092	8	28,101
セグメント利益 又は損失(△) (営業損失)	145	△719	△189	△764	△104	△869

(注) その他部品事業、リース事業、不動産賃貸事業及び労働者派遣事業

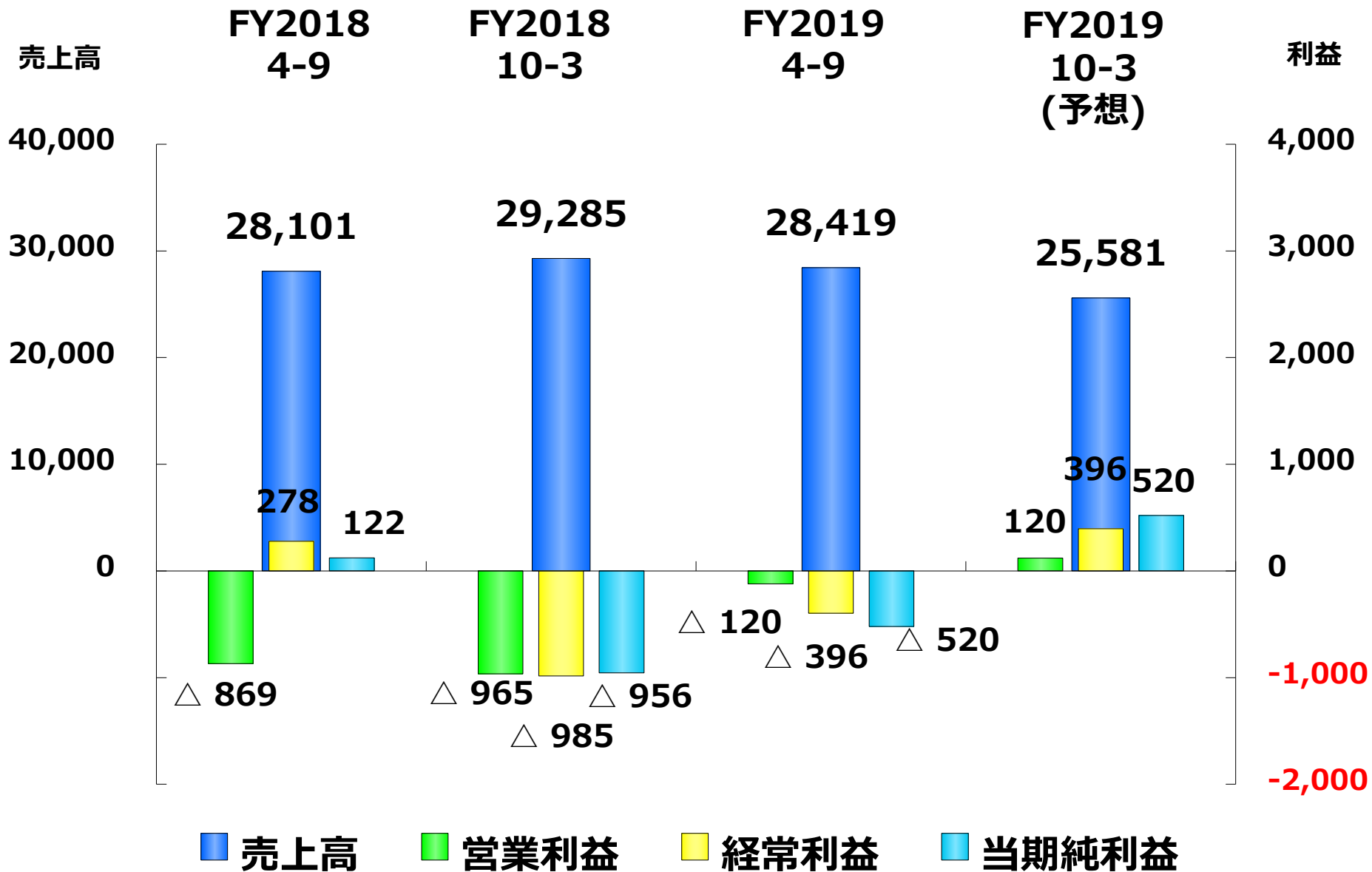
<連結> 業績推移 (通期)

(単位：百万円)



＜連結＞業績推移（半期）

（単位：百万円）



<連結> 財政状態

(単位：百万円)

	2019/3 (A)	2019/9 (B)	増減 (B - A)
資産	58,713	55,718	△2,995
現預金	10,889	9,614	△1,274
受取手形及び売掛金	14,496	15,004	507
棚卸資産	8,071	6,427	△1,643
固定資産	24,430	23,971	△458
負債	30,101	28,307	△1,793
買掛金及び未払金	6,792	6,896	103
有利子負債	18,865	17,154	△1,710
純資産	28,612	27,410	△1,201
資本金	7,996	7,996	-
自己資本比率	48.7%	49.2%	0.5%

〈連結〉キャッシュ・フローの状況

(単位：百万円)

	FY2018 4-9	FY2019 4-9
営業キャッシュフロー	66	2,407
運転資金	△1,689	1,613
税引前利益	420	△366
減価償却費	1,791	1,656
その他	△456	△496
投資キャッシュフロー	△2,335	△1,543
フリーキャッシュフロー	△2,269	864
財務キャッシュフロー	1,150	△2,146
有利子負債の増減額	1,424	△1,704
自己株式の増減額	△6	△113
配当金の支払金額	△263	△324
その他	△4	△5
現金等期首残高	10,482	10,776
現金等期末残高	9,014	9,511

年間配当金

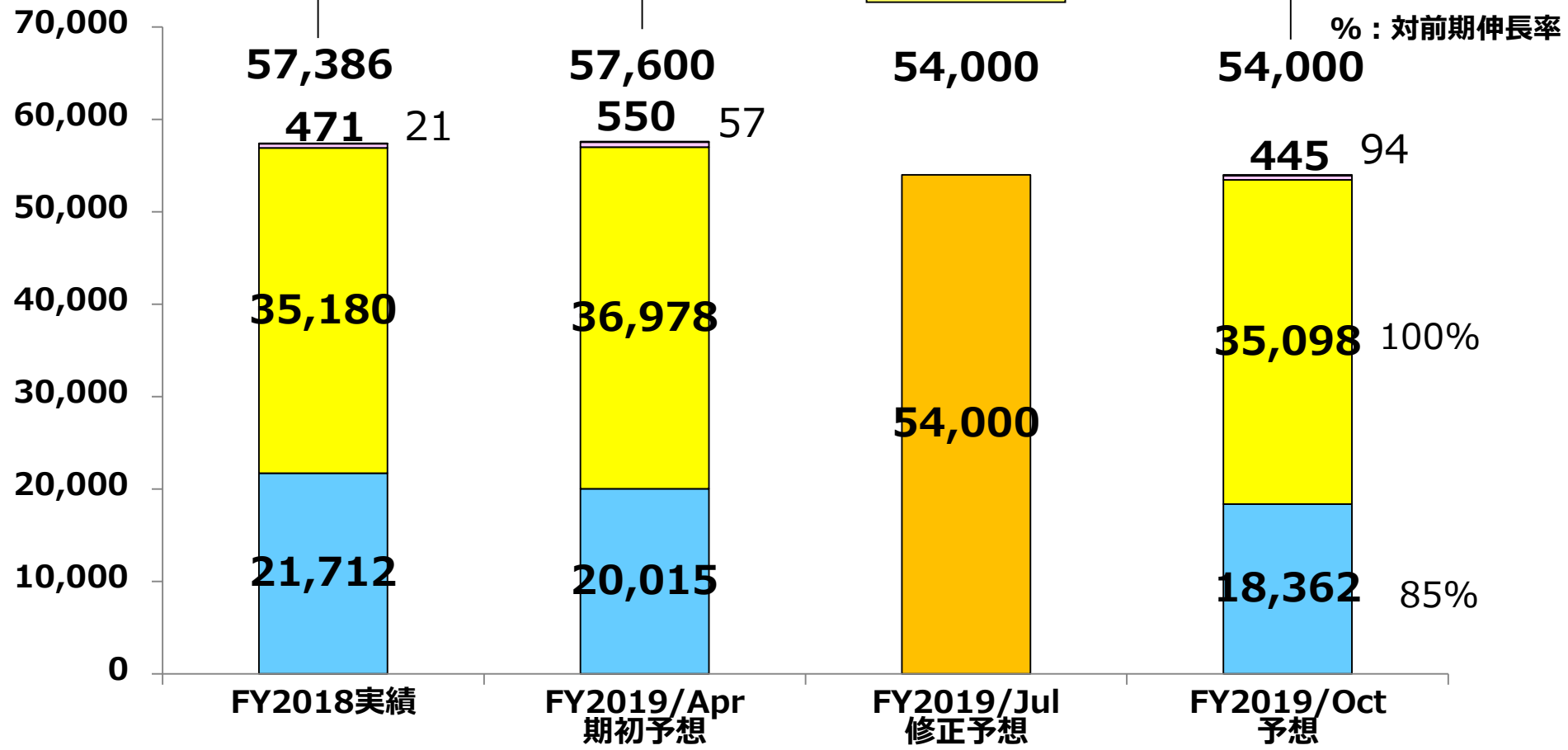
	第2四半期末	期 末	年 間
FY2018 (実績)	0円00銭	50円00銭	50円00銭
FY2019 (実績)	<u>0円00銭</u>	—	—
FY2019 (予想)	—	<u>50円00銭</u>	<u>50円00銭</u>

FY2019通期見通し

代表取締役社長 池田 靖光

事業部別 通期売上高 (FY2018-FY2019)

単位：百万円



為替レート 1USD=110.87JPY

108.00JPY

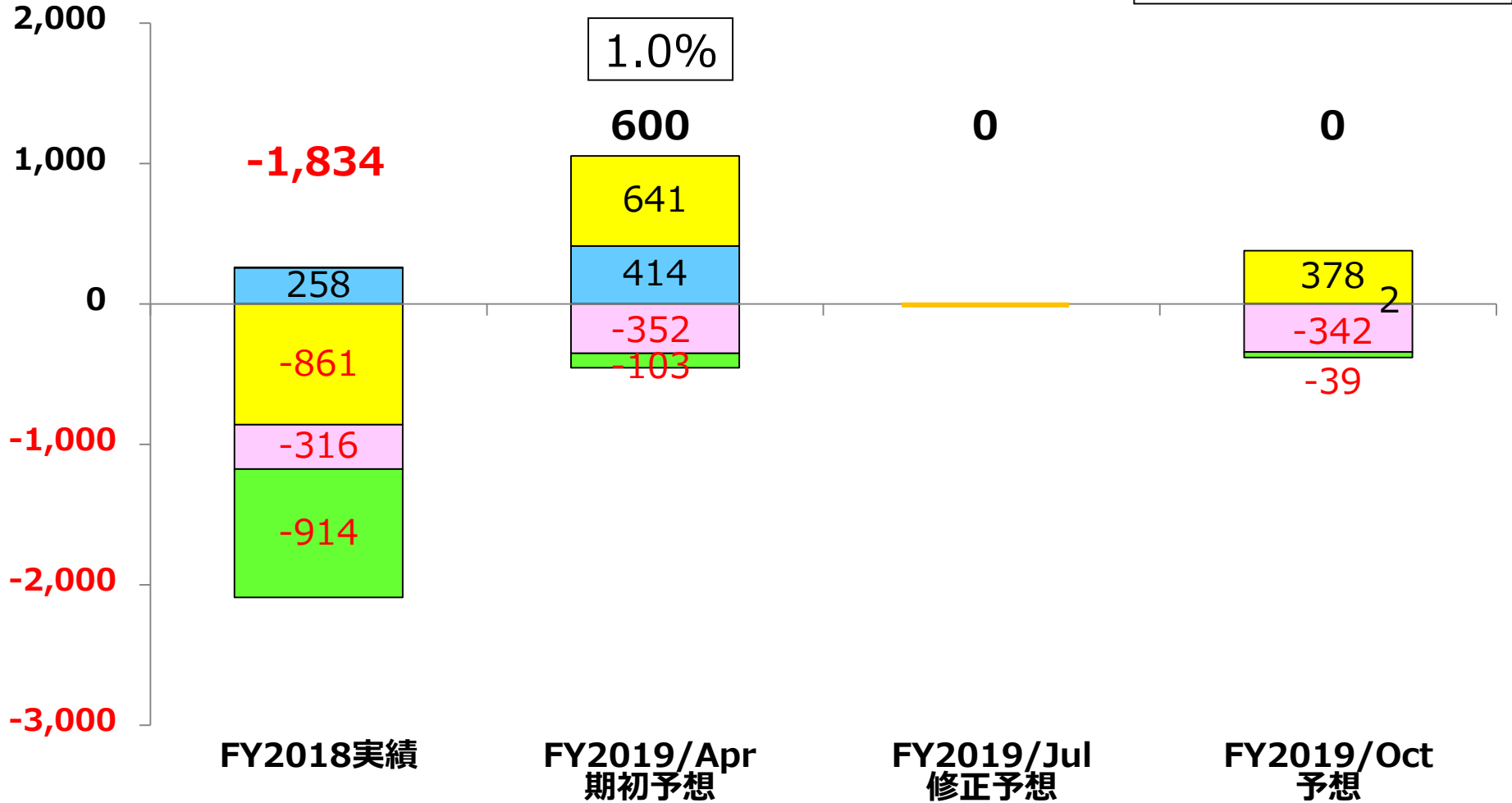
1H:108.93JPY
2H:108.00JPY

CS SCI R&D その他

事業部別 通期営業利益 (FY2018-FY2019)

利益率% = 利益 / 売上

単位：百万円



為替レート 1USD=110.87JPY

108.00JPY

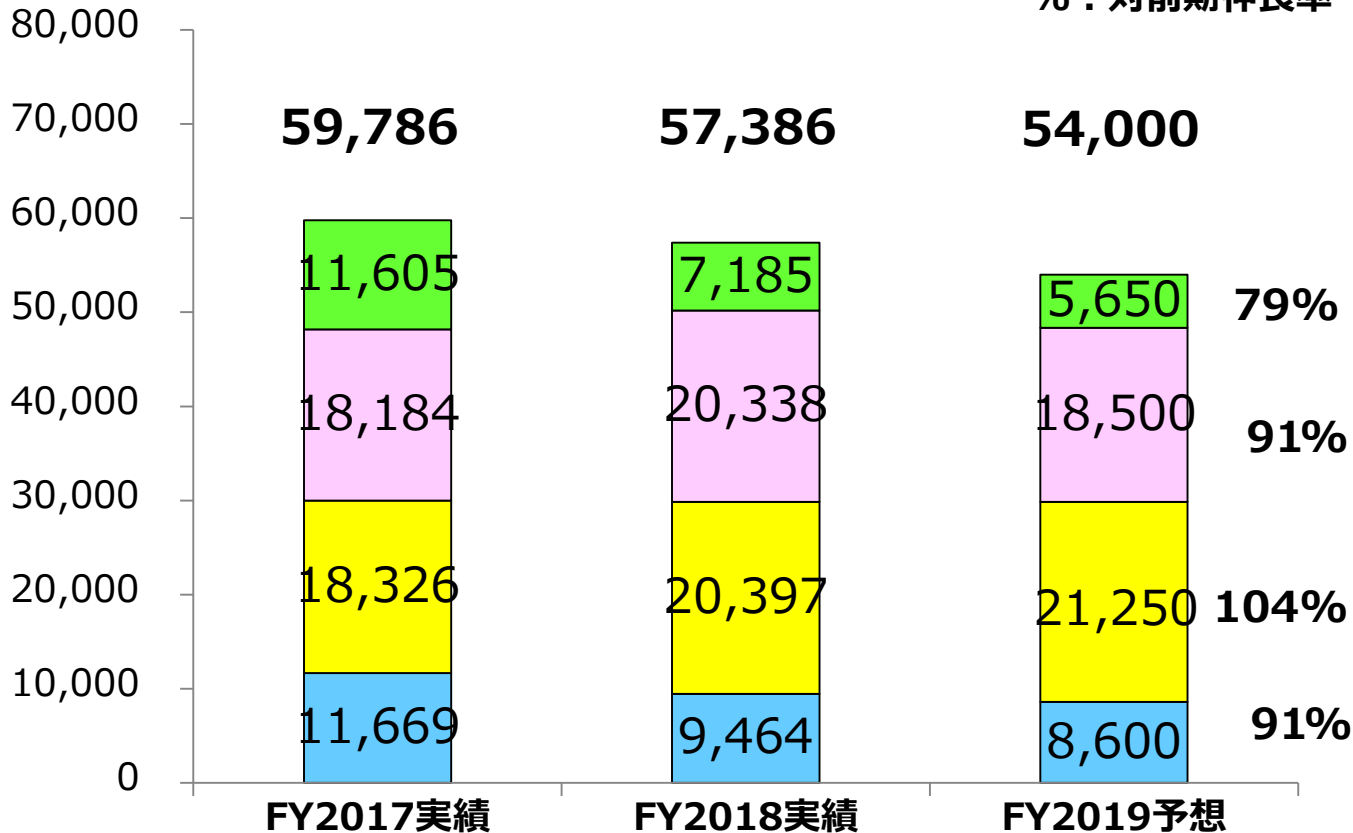
1H:108.93JPY
2H:108.00JPY

CS SCI R&D その他

参考:市場別 通期売上高 (FY2017-FY2019)

売上高：百万円

%：対前期伸長率



為替レート

1USD=110.94JPY

110.87JPY

1H:108.93JPY
2H:108.00JPY

■ 情報通信 ■ 家電 ■ 車載 ■ 産機・その他

ターゲット

産機他

- ・LPWA
- ・ヘルスケア
- ・プリンター
- ・再生エネルギー

車載

- ・CASE
- ・ADAS
- ・V2X
- ・EV/PHEV

家電

- ・スマート家電
- ・STB
- ・住宅設備

情報通信

- ・5G
- ・ウェアラブル
- ・中華系、米系VIC

- 1. 損益分岐点引き下げによる黒字化**
- 2. 新事業部体制、新営業体制
連携強化によるビジネス拡大**
- 3. オープンイノベーションによる
新規ビジネスの創出**

SMK東莞工場 One Stop Service 体制の確立

＜生産性向上及び新規受注獲得＞



車載市場に対する取組み

2018

2020

2025

自動運転
レベル

レベル
2

レベル
3

レベル
4

ターゲット

- ADAS
- V2X
- EV/PHEV

C

Connect
ed

A

Autono
mous

S

Shared

E

Electric

Connected

多極同軸コネクタ
MH-1シリーズ

5Gbps対応
10Pコネクタ

フローティング基板
対基板同軸コネクタ

Autonomous

Ethernet対応コネクタ

カメラモジュール

電波式乗員検知・
生体情報センサー

Safety

無線モジュール

カメラモジュール用
小型同軸コネクタ

Electric Entertainment

2ピースタイプ
FPCコネクタ

大型曲面カバーパネル付
静電容量方式タッチパネル

3D形状スイッチパネル

HP renewal

SMKのCASEへの取り組み

クルマは、「接続」「自動運転」「安全」「電子化/エンタテインメント」という大きな技術テーマを抱え、これらのニーズに応えるため、エレクトロニクス化・電子制御化が急速に進んでいます。

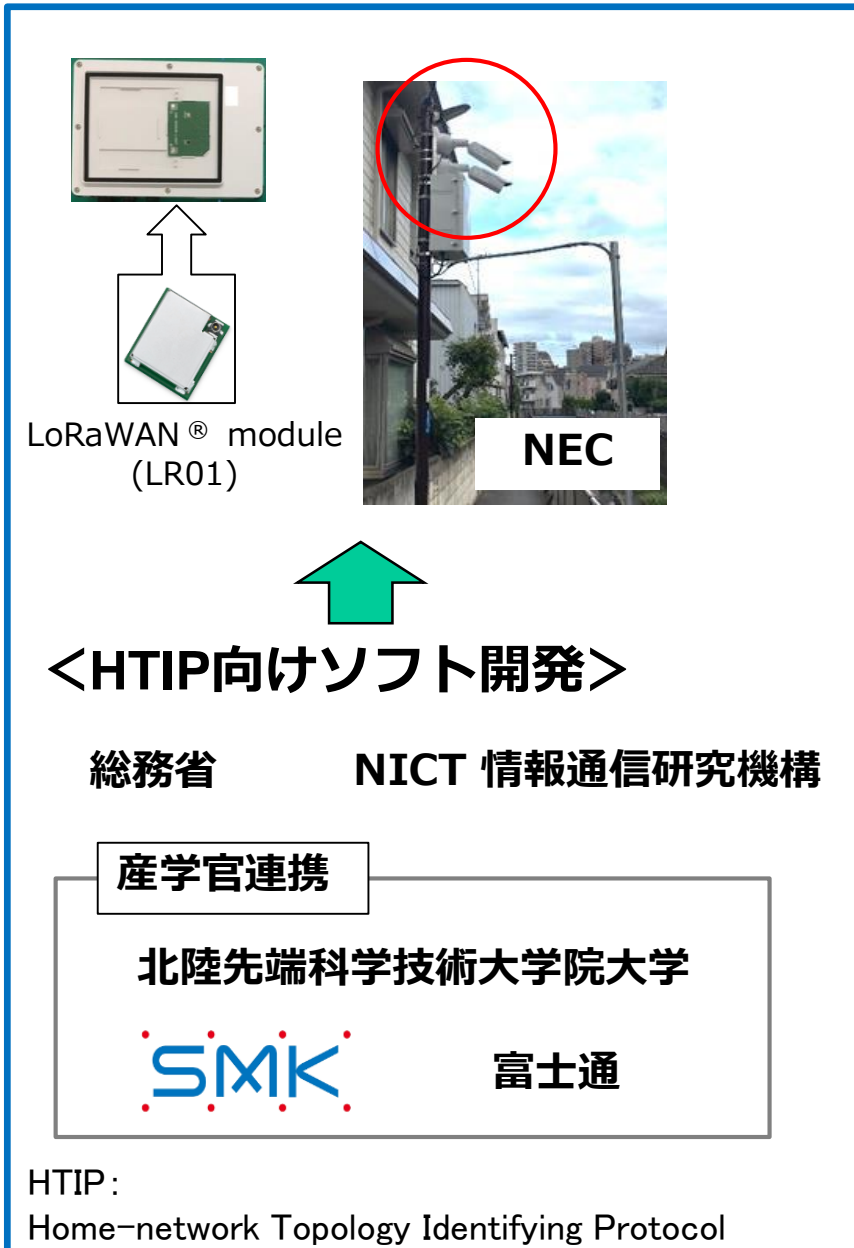
SMKではこれらのニーズに応える車載仕様に準拠した製品開発を推進しており、タッチパネル、コネクタ、リモコン、モジュール製品の商品カテゴリーにおいてさまざまなソリューションの提案を行っています。

「Connected」、「Autonomous」、「Safety」、「Electric/Entertainment」のテーマに沿った製品を以下のリンクよりご紹介させていただきます。
ご興味をもたれる製品がございましたら、お気軽にお問い合わせください。



C A S E

開発センターの取組み事例



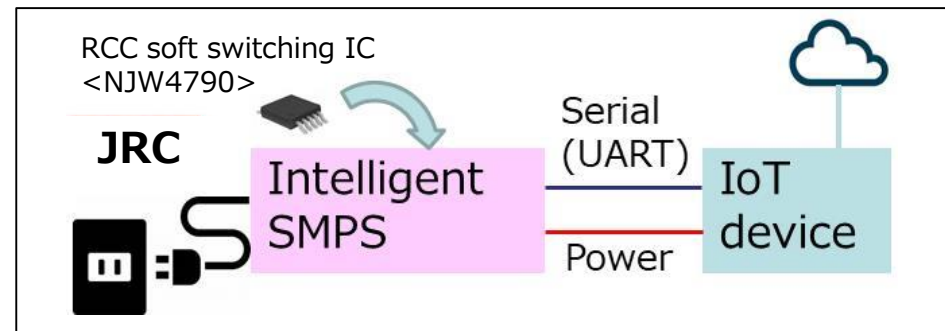
NEC社が杉並区でスマート街路灯の実証開始。
SMK製無線モジュールが採用。

スケジュール	2019	2020	2021
電源モジュール	実証	Pilot	量産
HTIP向けソフト	実証	Pilot	量産
インテリジェント電源		実証	Pilot

<次世代提案>

IoT機器向けインテリジェント電源

10~20%の軽負荷動作時でも、電気効率が従来比13%向上



注意事項

この資料に掲載されている業績見通し、その他今後の予測・戦略等に関わる情報は、本資料の作成時点において当社が合理的に入手可能な情報に基づき、通常予測し得る範囲内で行った判断に基づくものです。

しかしながら現実には、通常予測し得ないような特別の事情の発生等により、本資料記載の業績見通しとは異なる結果を生じる可能性があります。

当社といたしましては、投資家の皆様にとって重要と考えられるような情報について、その積極的な開示に努めて参りますが、本資料記載の業績見通しのみで全面的に依拠してご判断されることはくれぐれもお控えになられるようお願いいたします。

商標について

- * Android は Google LLC の商標です。
- * Bluetooth®のワードマークおよびロゴは、Bluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、SMK株式会社はこれらのマークをライセンスに基づいて使用しています。
- * Ethernetは、富士ゼロックス株式会社の登録商標です。
- * LoRaWAN® のリードマークはLoRa Alliance ™が所有する登録商標であり、SMK株式会社は、このマークをライセンスに基づいて使用しています。
- * その他記載されている社名・商品名などは各社の商標または登録商標です。